

印度 2026-27 年聯邦預算案影響簡析

市場情報中心 X 駐新德里辦事處

2026.03.18 撰擬

摘要

根據財政部統計數據顯示，2025 年臺灣對印度出口達 92.1 億美元，成長率為 16.7%，自印度進口為 33.0 億美元，臺對印貿易順差為 59.1 億美元，貿易總額達到 125.1 億美元，出口高度集中於電子零組件，其占比為 53%。印度於 2026 年 2 月 1 日向其國會提交聯邦預算案，預期將增加對半導體產業之政策支持。經分析，印度新財政年度之預算案政策走向對我有以下可能影響：第一，「電子零組件製造計畫」將擴大補貼與對設備材料需求，對我出口電子零組件有利。第二，印度積極控管地緣政治風險，欲建立自主製造組裝量能，可能衝擊臺對印出口之中下游產品。第三，「印度半導體任務 2.0」目標旨在實現半導體設計與智財權自主，惟我在半導體設計與智財權佔據領先地位，短期內印度較難有所突破，為我之優勢。

壹、印度 2026-27 年聯邦預算案核心洞察

根據印度憲法第 112 條，印度聯邦中央政府（以下簡稱：印度政府）每年須向國會提交年度財務報表，稱之為「年度財政收支報告」(Annual Financial Statement)，一般通稱為「聯邦預算」。¹ 聯邦預算詳細羅列印度政府未來財政年度的預計收入與支出，印度以提交預算案之當年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日為一財政年度，決定有關稅收提案、相關政策撥款計畫及經濟政策，向來是作為觀察印度未來一年政策走向、稅制改革及產業扶持的重要風向標。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 於當地時間 2026 年 2 月 1 日向國會提交 2026-27 年度「中央總預算」(Union Budget)，2026-27 財年之中央總預算具歷史性意義，觀之其政策走向將著重加速改革、促進經濟成長。預算將強化中小微企業

¹ Government of India, Ministry of Finance, Union Budget Documents 2026-2027, <https://www.indiabudget.gov.in/>。

發展、加速基礎建設、推動「印度製造」(Make in India)與「自立印度」(Atmanirbhar Bharat)，其重點在於支持半導體、電子零組件、生技製藥、稀土與關鍵礦物等關鍵產業之發展。

(一)焦點：產業扶助政策

其一，著力於升級「印度半導體任務 2.0」(India Semiconductor Mission 2.0, ISM 2.0)政策，持續挹注資源於以半導體為核心等戰略產業。預算將支持半導體設備和材料的生產，提升設計能力，並強化供應鏈。該預算案還提議建立由行業主導的研究和培訓中心，以增強技術實力並培養專業技術人才，特別是針對晶片設計方面大力推動減少對外國智慧財產權的依賴，建立印度本土的智慧財產權韌性。

其二，聚焦於「電子零組件製造計畫」(Electronics Component Manufacturing Scheme, ECMS)，該預算案提議將 2025 年 4 月啟動的該計畫的撥款額增加到 4,000 億盧比(約 43 億美元)，²以加速擴大產能，並促進電子關鍵零組件的本土化，吸引全球對其投資，打造在印本土完整的零組件生態系統，以強化印自身經濟安全與供應鏈韌性。

(二)焦點：稅務政策調整優化

首先，印度政府將對使用其本地數據中心之外國公司提供稅收豁免，優惠期至 2047 年，並對資本設備供應商提供至 2031 年為期五年的免稅待遇。印度宣布取消多項關鍵礦產(Critical Minerals)之加工設備的進口關稅，也針對特定稀土金屬化合物實施關稅豁免，包括鋰電池生產設備以及生產太陽能玻璃之銻酸鈉。此外，針對航太、國防之維護修理與翻修(maintenance, repair & overhaul)與電子產業所需的原材料，印度政府也同步豁免或者調降稅率。

再者，預算案中對「境外所得免稅」做出調整，針對參與印度政府指定計畫(Notified Schemes)的非居民專家或個人，其在印度境外賺取所得可享有連續五個課稅年度免稅期。此舉旨在吸引高技術專業人才響應印度創新與研發政策，並透

² Electronics Components Manufacturing Scheme: Union Budget 2026–27 Raises Scheme Outlay to ₹40,000 Crore, 2026 年 2 月 3 日，PIB Headquarters, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222519®=3&lang=1>

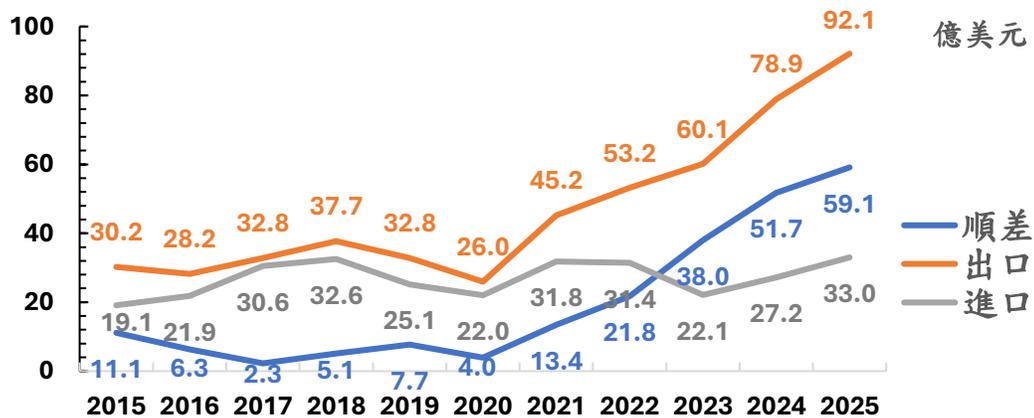
過稅收減免與關稅調整雙管齊下，印度正採取積極的舉措，定義其在全球供應鏈中的角色。

聯邦預算案在印度國會表決通過後，涉及稅收及財政部分將形成《2026 年財政法》與有關政府支出之《撥款法》，經由印度總統簽屬並根據適用法律發佈後將正式生效。由執政黨印度人民黨(BJP) 所領導之全國民主聯盟(NDA) 目前居印度國會過半數席次情況下，預計相關國會審查應能順利通過。以下依印度最新情勢發展資訊，結合臺印雙邊貿易結構及現況，扼要評析對臺印貿易可能之影響。

貳、回顧臺對印貿易規模與進出口：出口額與貿易順差創歷史新高

COVID-19 疫情期間臺對印的出口總額大體持平，受疫情影響至 2020 年觸及近十年低點的 26.0 億美元。但從 2020 年起臺對印出口開始展現穩定且持續增長的趨勢，從 2020 年 26.0 億美元一路攀升至 2025 年為 92.1 億美元，2025 年出口成長率為 16.7%。再者，臺對印貿易之順差表現亮眼，從 2020 年臺對印順差僅 4.0 億美元大幅度成長至 2025 年的 59.1 億美元，於出口額與貿易順差均創下歷史紀錄。

圖 1：2015-2025 年臺灣對印度進出口及順差概況

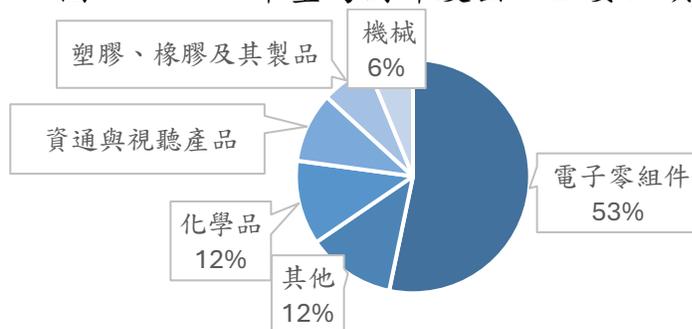


資料來源：Trade Data Monitor。

參、臺灣出口關鍵產品：電子與資通訊產品成長攀升

觀察 2025 年臺灣出口印度之主要產品，可發現臺對印出口品項高度集中於電子零組件與資通訊產品，其中主要產品為：電子零組件占比達 53%、資通訊與視聽產品占比為 10%、化學品與基礎材料占比為 12%、塑膠橡膠及其製品占比為 7% 與機械設備占比為 6%，若以電子相關產品觀察計算(包含電子零組件與資通訊與視聽產品)占比則達 63%。

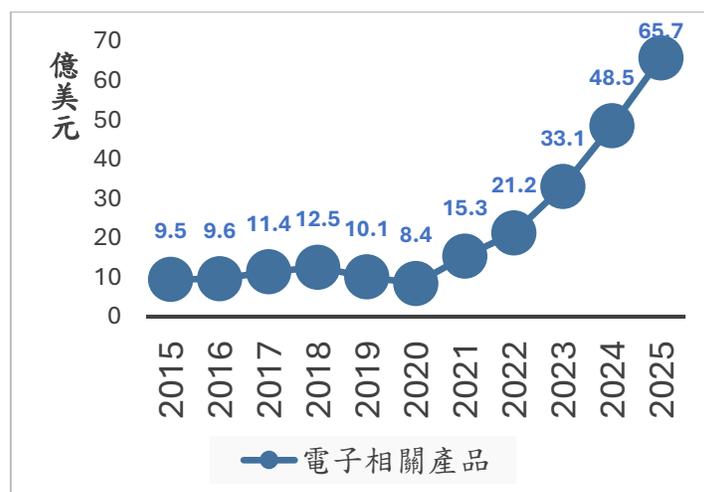
圖 2：2025 年臺灣對印度出口主要品項占比



資料來源：財政部統計處。

臺對印之出口主力高度地集中在電子相關產品，其出口值在 2020 年前趨勢雖較為平緩，2020 年後則出現明顯轉折，從 8.4 億美元增長到 2025 年的 65.7 億美元，在電子零組件、資通產品的帶動下，臺對印出口額與貿易順差大幅增加。

圖 3：近十年臺灣出口至印度電子相關產品情況
(含電子零組件、電機產品與資通視聽產品)



資料來源：財政部統計處。

若從臺對印出口產品細項觀察，「其他積體電路」(HS 854239) 是臺對印出口的最核心產品，其出口額高達 45.64 億美元，佔出口總額的 49.5%。值得關注的是，該品項年增長率達 65.4%。除了積體電路之外，「手機及網通產品零件」(HS 851779)之增長率達 64.2%，出口額約 1.98 億美元，「電腦之零附件」(HS 847330)亦有 19.4%的增長。「伺服器」(HS 847150)與「交換器、路由器」(HS 851762)的出口額在 2025 年則是出現負成長。

表 2025 年全年度臺灣對印度出口前十大產品

單位：億美元；%

HS Code	品項	出口額	占比	增長率
總計		92.1	100	16.7
854239	其他積體電路	45.64	49.5	65.4
291736	對苯二甲酸及其鹽類	2.43	2.6	-42.0
851779	手機及網通產品之零件	1.98	2.2	64.2
390410	聚氯乙炔，未與任何其他物質混合者	1.98	2.2	-39.5
851762	交換器、路由器	1.53	1.7	-13.0
847150	伺服器	1.42	1.5	-25.6
292610	丙烯腈	1.41	1.5	22.3
271019	中等油品及製劑	1.39	1.5	31.7
847330	電腦之零附件	1.26	1.4	19.4
722519	其他電氣矽鋼扁軋製品	0.99	1.1	13.4

資料來源：Trade Data Monitor。

肆、印度 2026 聯邦預算案聚焦電子零組件製造，對我出口電子產品之動態影響

根據印度政府所提交之 2026 年最新預算案有兩項重大產業政策焦點，首先，「電子零組件製造計畫」(ECMS)，吸引印度本土與全球對其投資，旨在強化印度自身經濟安全與其供應韌性。另一重點政策項目為「印度半導體任務 2.0」(ISM 2.0)，為晶圓廠、封測廠與設計中心提供補貼，強調建立完整半導體生態不再只專注於前端製造，特別是針對晶片設計方面大力推動減少對外國智慧財產權的依賴，建立印度本土的智慧財產權韌性。針對印度聯邦預算案之對臺影響觀察如下：

第一，根據進出口數據顯示，「其他積體電路」(HS 854239) 於臺對印前十大出口品項中占近 50%的額度。2026 年聯邦預算案中明確表示將擴大補貼及展現對設備與材料之需求，此機遇下或許能夠進一步牽動臺灣出口半導體、PCB 及相關被動零組件的成長。

第二，從聯邦預算案中觀察印度未來有關半導體產業政策，明顯展現積極強化本土製造供應鏈，臺灣對印度的出口結構也出現轉型。從數據上來看，臺伺服器 (HS 847150) 與交換器、路由器 (HS 851762) 的出口額在 2025 年出現負成長。印度政府近年為控管地緣政治風險，重組供應鏈的戰略逐漸清晰，積極建構自主生產組裝的量能。然本預算案仍須經印度國會審查通過，目前莫迪總理之聯合執政陣營仍居國會過半數席次情況下，預期審查應能順利通過。在未來政策環境下臺灣出口印度之電子相關「中下游產品」可能繼續面臨印度當地「進口替代」壓力。因此，應進一步探討臺商是否應從「純出口」轉向「在印合資設廠」，臺商應考慮將下游產品的組裝與生產基地移往印度，或與當地廠商建立合資企業，以化解「政策性排擠」並維持市場份額。

第三，印度 ISM 2.0 計畫之重點在於補貼半導體相關生產設備、自主智財權 (India IP) 創新設計及扶持本土設計公司，臺灣在半導體設計與智財權領域佔據領先地位，印度短期之內可能較難於此間領域有所突破，不過應仍需審慎應對印度政策變化所帶來的挑戰。在長期上可能涉及技術轉移的壓力，臺商應持續強化高端設計能力，在競爭中保持主動。除此之外，預算案提供參與指定計畫的非居民專家為期五年的境外所得免稅期，臺商可利用此激勵措施，派遣核心技術人員或研發專家赴印，與印度進行技術交流。

總結來說，臺商應考慮朝「製造在地化」、「技術與人才交流」等複合策略前進，同時利用印度預算案中的各項補貼與稅務便利措施，例如：外國實體（臺商）若向保稅區內從事電子產品製造的代工廠商提供資本貨物、設備或工具，其產生的所得可享有自 2026 年起為期 5 年的所得稅豁免。這有將助於降低進入印度市場門檻，或可減緩進口替代政策帶來的潛在衝擊。印度未來將積極發展技術，制定指導政策與經濟治理以尋求突破，此外，印度的企業在信用、付款以及技術能力都會持續提升，臺商仍可審慎樂觀地看待印度市場的機遇與發展潛力。